

翱捷科技科創板成功上市，光大控股 斬獲新年首個 IPO

2022 年 1 月 14 日，光大控股旗下光控華登全球基金一期（「光控華登基金」）投資企業——翱捷科技股份有限公司（688220.SH，「翱捷科技」）在上海科創板成功發行上市，成為國內通訊基帶芯片領域第一家 A 股上市企業。光控華登基金於 2018 年 6 月聯合領投翱捷科技 B 輪融資，該項目是光大控股在通訊半導體芯片領域的重要佈局。



翱捷科技於 2015 年 4 月在上海成立，以成為世界級芯片公司作為發展目標，是一家提供無線通信、超大規模芯片的平台型芯片企業。公司專注於無線通信芯片的研發和技術創新，同時擁有全制式蜂窩基帶芯片及多協議非蜂窩物聯網芯片研發設計實力，且具備提供超大規模高速 SoC 芯片定制及半導體 IP 授權服務能力。公司各類芯片產品下游應用場景廣闊，可應用於以手機、智能可穿戴設備為代表的消費電子市場及以智慧安防、智能家居為代表的智能物聯網市場。翱捷科技業務經營發展迅猛，最近 3 年收入複合增長率超過 200%，2020 年營業收入規模已達 10.8 億元人民幣。

在不斷完善 2G 到 4G 全制式蜂窩通信技術的基礎上，翱捷科技研發團隊憑藉豐富的產品開發經驗及高效協同的工作機制，陸續取得諸多技術突破，成為國內少數同時掌握 5G 及 AI 等核心技術的企業。蜂窩移動通信技術是芯片設計領域最先進、最難掌握的技術之一。與 4G 相比，5G 技術融合了先進的信道編解碼、調製解調和 Massive MIMO 等技術，能夠提供遠高於 4G 的傳輸速率，並在高可靠性、低延時等方面取得了巨大的突破，滿足了工業物聯網、車聯網應用等各新興應用場景的嚴苛要求。公司創新性開發了射頻、基帶一體化的單芯片產品，具備比同類企業更強大的射頻基帶整合能力。

截至 2021 年 6 月底，翱捷科技已成功量產超過 25 顆全新芯片，產品線全面覆蓋蜂窩通信領域、非蜂窩通信領域、AI 領域，實現了在非蜂窩、AI 領域的產品突破，逐步與各領域的龍頭企業達成合作關係，並實現大規模銷售。公司已成為國內外主流模組廠商的重要供應商，並進入了國家大型電網企業等國內外知名通訊企業的供應鏈體系。公司的產品已經打入國際巨頭長期主導的市場。

光大控股科技投資基金部範文含表示：翱捷科技是國內通信領域基帶芯片設計及解決方案供應商龍頭，在 5G 商用技術研發方面亦積極佈局，公司的產品及技術在消費電子及工業互聯網領域皆具有廣闊的市場潛力。光控華登基金投資後將進一步賦能企業拓展產業鏈整合，通過靈活多樣的金融服務支援企業加速佈局海內外市場，助力公司成長為一家立足中國的世界級芯片企業。

光控華登基金由光大控股和華登國際共同運作，一期總規模為 1.88 億美元，由光大控股科技投資基金部團隊負責投資管理。基於對國產芯片賽道的長期看好，及對翱捷科技創始人團隊、產品發展及技術儲備的充分認可，光大控股協同華登國際於 2018 年 6 月領投了翱捷科技 B 輪融資。未來，光大控股將繼續挖掘半導體芯片賽道的優質投資標的以創造更好的投資回報。翱捷科技是光控華登基金第六個上市項目，此前，光控華登基金已上市的半導體公司還包括半導體清洗設備公司盛美半導體、通信芯片設計企業 Aquantia、汽車電子芯片設計廠商 Indie Semiconductor 及數據芯片龍頭企業 Marvell Technology 等。